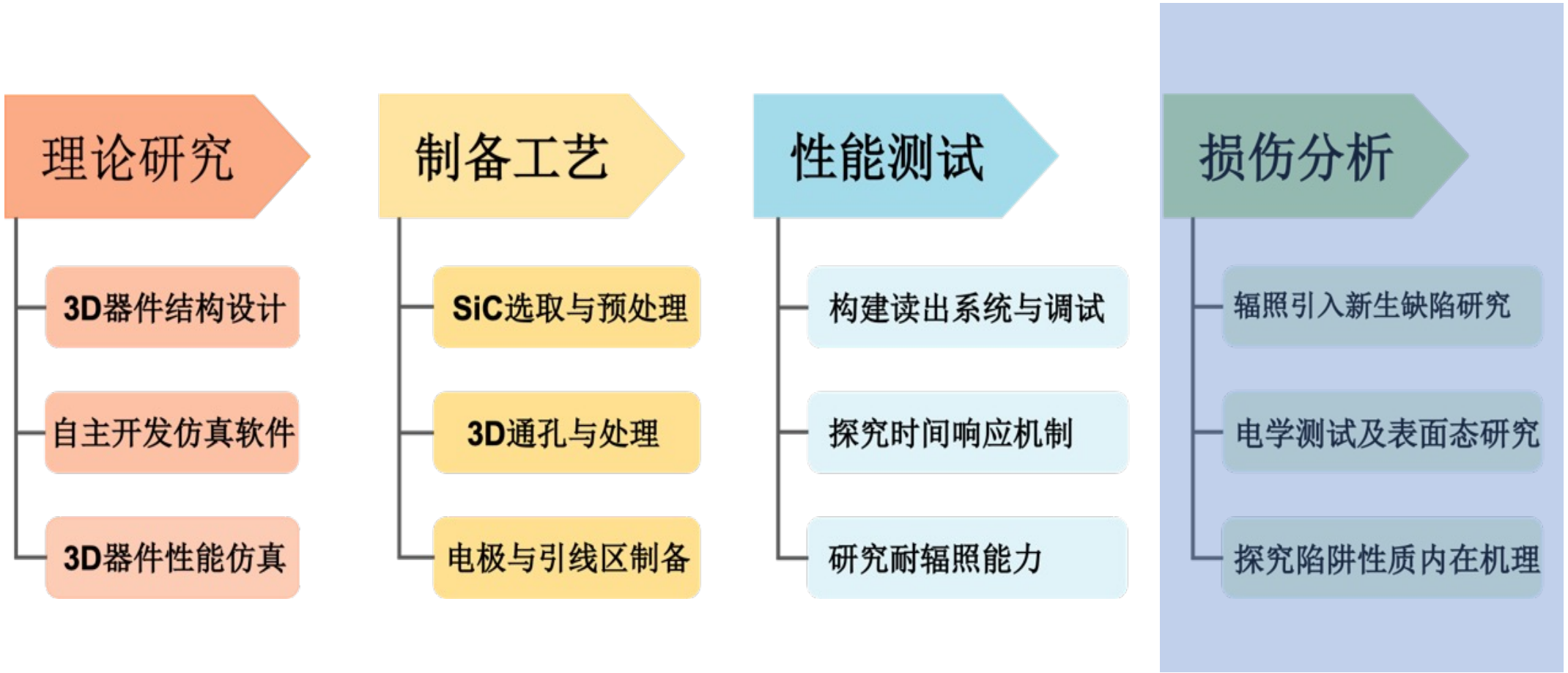
碳化硅探测器 – 损伤分析

史欣

2022年7月22日

技术路线


理论研究
3D器件结构设计
自主开发仿真软件
3D器件性能仿真
制备工艺
SiC选取与预处理
3D通孔与处理
电极与引线区制备
性能测试
构建读出系统与调试
探究时间响应机制
研究耐辐照能力
损伤分析
辐照引入新生缺陷研究
电学测试及表面态研究
探究陷阱性质内在机理

会议日程

Friday, 22 July 2022

09:00 - 09:05	损伤分析 *5'* Speaker: Xin Shi (IHEP)
09:05 - 09:30	碳化硅缺陷仿真进展 *25'* Speaker: Tao Yang (IHEP)
09:30 - 09:55	半导体光致发光现象 *25'* Speaker: 晓川 夏 (Dalian University of Technology)
09:55 - 10:00	AOB *5'*